PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-145955

(43) Date of publication of application: 22.05.2002

(51)Int.CI.

C08F220/28 C08F220/18 CO8J 3/14 GO3F 7/039 GO3F H01L 21/027 // CO8L 33:04

(21)Application number: 2001-185580

(71)Applicant: DAICEL CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

19.06.2001

(72)Inventor: TSUTSUMI KIYOHARU

FUNAKI KATSUNORI

(30)Priority

Priority number: 2000265811

Priority date: 01.09.2000

Priority country: JP

(54) POLYMER COMPOUND FOR PHOTORESIST AND RESIN COMPOSITION FOR **PHOTORESIST**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymer compound for photoresist, containing uniformly distributed monomer units, having small intramolecular and intermolecular compositional distributions and synthesizable at a low cost.

SOLUTION: The polymer compound for photoresist can be produced by the copolymerization of a monomer mixture containing at least three kinds of (meth)acrylic acid esters comprising (A) a (meth)acrylic acid ester having a 6-20C alicyclic hydrocarbon group containing lactone ring and bonded to oxygen atom constituting the ester bond, (B) a (meth)acrylic acid ester having a 6-20C alicyclic hydrocarbon group and a group eliminable by the action of an acid and bonded to oxygen atom constituting the ester bond and (C) a (meth) acrylic acid ester having a hydrocarbon group containing a polar substituent or an oxygen-containing heterocyclic group bonded to oxygen atom constituting the ester bond.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-145955 (P2002-145955A)

(43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

						(43) 23	# D -	平成14平 5 月	22 [(2002. 5. 22)
(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				テーマコート*(参考)	
C08F	220/28			CO	8 F	220/28			2H025
	220/18					220/18			2H096
C 0 8 J	3/14	CEY		CO	8 J	3/14		CEY	4F070
G03F	7/039	6 0 1		G 0	3 F	7/039		601	4 J 1 O O
	7/26	501				7/26		501	
			審査請求	未請求	於 簡	マスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタ	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-185580(P2001-	-185580)	(71)出願人 000002901			⊤₩₩-₽ ♠₩		
(22)出顧日		平成13年6月19日(2001.6.	19)	ダイセル化学 大阪府堺市鉄				-	
(31)優先権主張番号		######################################	D0000 005011)		発明者	·			
		特願2000-265811 (P2000-			-			網干区新在家	5940
(32) 優先日		平成12年9月1日(2000.9.	1)	(72)	発明者				
(33)優先権主張国		日本(JP)	-				姪路市	網干区新在家	1367 — 5
				(74)代理人 100101362		362			
						弁理士	後藤	幸久	
		·							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フォトレジスト用高分子化合物及びフォトレジスト用樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 各モノマーユニットが偏在せず、分子間や分子内で組成分布の小さい高分子化合物であって、しかも合成コストを低減できるフォトレジスト用高分子化合物を得る。

【解決手段】 フォトレジスト用高分子化合物は、

(A) ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、(B)炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、及び(C)極性の置換基を有する炭化水素基又は酸素原子含有複素環基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合して得られる。

【特許請求の範囲】

(A) ラクトン環を含有する炭素数6~ 【請求項1】 20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素 原子に結合している (メタ) アクリル酸エステル、

(B) 炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ 酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する 酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、 及び(C)極性の置換基を有する炭化水素基又は酸素原 子含有複素環基がエステル結合を構成する酸素原子に結 合している (メタ) アクリル酸エステルの3種の (メ タ) アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物 を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物。 【請求項2】 (A)、(B)及び(C)の3種の(メ タ) アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物 を共重合し、生成したポリマーを含む溶液を有機溶媒中 に添加することにより沈殿又は再沈殿して得られる請求

【請求項3】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶 媒が、炭化水素、ハロゲン化炭化水素、ニトロ化合物、 ニトリル、エーテル、ケトン、エステル、カーボネー ト、アルコール、カルボン酸又はこれらの溶媒を含む混 合溶媒である請求項2記載のフォトレジスト用高分子化 合物。

項1記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項4】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶 媒が少なくとも炭化水素を含む請求項2記載のフォトレ ジスト用高分子化合物。

【請求項5】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶 媒のFedorsの方法による溶解度パラメーターの値 $357.0 (cal/cm^3)^{1/2} \sim 14.0 (cal/c$ m³) ¹/² [14.3MPa¹/²~28.6MPa¹/²]の 30 ーターの値が9.5 (cal/cm³) ¹/²~12.0 範囲である請求項2記載のフォトレジスト用高分子化合 物。

【請求項6】 (メタ) アクリル酸エステル (C) のF edorsの方法による溶解度パラメーターの値が1 0. 0 $(ca1/cm^3)^{1/2} \sim 11.5 (ca1/cm$ ³) ¹/² [20. 5MPa¹/²~23. 5MPa¹/²] の範 囲である請求項1~5の何れかの項に記載のフォトレジ スト用高分子化合物。

【請求項7】 (メタ) アクリル酸エステル(C) の共 重合比率が1~50モル%であり、重量平均分子量が 1,000~500,000である請求項1~6の何れ かの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項8】 下記式(1)又は(2) [化1]

(式中、R1、R1、R6は、それぞれ独立に、水素原子 又はメチル基を示す。R'は水素原子又は炭素数1~1 3の炭化水素基を示す。R'及びR'は、それぞれ独立 に、炭素数1~3の炭化水素基を示す。Rは炭素数2~ 20 20の炭化水素基を示す。R'及びR*は、前記Rの置換 基であり、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル 基、オキソ基又はカルボキシル基を示す。但し、R'及 びR®のうち少なくとも一方は水素原子以外の置換基で ある。R[®]はメチル基又はエチル基を示す。x、y、z t, 0. $9 \le x + y + z \le 1$, 0 < x < 0. 99, 0 < x < 0y<0.99、0.01≤z≤0.50を満たす数であ る)で表される共重合構造を有する請求項1~7の何れ かの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項9】 Fedorsの方法による溶解度バラメ $(cal/cm^3)^{1/2}[19.4MPa^{1/2}\sim24.5]$ MP a 1/1] の範囲である請求項 1~8 の何れかの項に 記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項10】 (A) ラクトン環を含有する炭素数6 ~20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸 素原子に結合している (メタ) アクリル酸エステル、

(B) 炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ 酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する 酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、 及び(C)極性の置換基を有する炭化水素基又は酸素原 子含有複素環基がエステル結合を構成する酸素原子に結 合している (メタ) アクリル酸エステルの3種の (メ タ) アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物 を共重合することを特徴とするフォトレジスト用高分子 化合物の製造法。

【請求項11】 請求項1~9の何れかの項に記載のフ ォトレジスト用高分子化合物と光酸発生剤を少なくとも 含むフォトレジスト用樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001] 50

1

【発明の属する技術分野】本発明は半導体の微細加工などを行う際に用いるフォトレジスト用の高分子化合物と、この高分子化合物の製造法、及び前記の高分子化合物を含有するフォトレジスト用樹脂組成物に関する。 【0002】

【従来の技術】半導体製造工程で用いられるフォトレジスト用樹脂は、基板密着性を示す部分と、露光によって光酸発生剤から発生する酸により脱離してアルカリ現像液に対して可溶になる部分が必要である。また、フォトレジスト用樹脂は、ドライエッチング耐性をも具備して 10いる必要がある。

【0003】従来、基板密着性を付与し、且つドライエ ッチング耐性を有する構造として、ラクトン環を含有す る脂環式炭化水素骨格が知られている。また、酸脱離性 を付与し、且つドライエッチング耐性を有する構造とし て第3級炭素原子を含有する脂環式炭化水素骨格が提案 されている。従って、これらの2つの骨格を有する単量 体を共重合させれば、フォトレジスト用樹脂に必要な機 能が集積されたポリマーを得ることが可能である。しか し、実際には、前記ラクトン環を含有する脂環式炭化水 20 素骨格を有する単量体は極性が非常に高い一方、前記第 3級炭素原子を含有する脂環式炭化水素骨格を有する単 量体は極性が非常に低いという特徴を持っていることか ら、両単量体を共重合に付すと、前者は前者、後者は後 者で単独重合する傾向があり、その結果、ランダム重合 体にはならずに分子間或いは分子内で大きな組成分布を 持つポリマーが生成しやすい。このようなポリマーをフ ォトレジスト用樹脂として用いると、フォトレジスト用 の溶媒に溶解しにくい、基板にスピンコートする際に相 分離構造を形成してレジストバターンの形成の障害とな る等の不具合が生じやすい。また、モノマーや、オリゴ マー等の低分子量物を含むポリマーをフォトレジスト用 樹脂として用いると、微細なパターンを精度よく形成で きない場合が生じる。

【0004】また、このような重合時の問題を回避するため、酸脱離性脂環式炭化水素基に極性置換基を付加した化合物が提案されているが、このような化合物は合成に手間がかかるため、合成コストが高くなる難点がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、各モノマーユニットが偏在せず、分子間や分子内で組成分布の小さい高分子化合物であって、しかも合成コストを低減できるフォトレジスト用高分子化合物の製造方法、及び該フォトレジスト用高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供することにある。

【0006】本発明の他の目的は、基板に対する密着性、アルカリ可溶性及びエッチング耐性に優れるとともに、フォトレジスト用溶媒に溶解しやすく、しかも製造 50

コストの安いフォトレジスト用高分子化合物と、該フォトレジスト用高分子化合物の製造方法、及び該フォトレジスト用高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供することにある。

【0007】本発明のさらに他の目的は、微細なバターンを精度よく形成できるフォトレジスト用高分子化合物と、該フォトレジスト用高分子化合物の製造方法、及び該フォトレジスト用高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、特定の基板密着性脂環式エステルと特定の脂環式骨格を有する酸脱離性のエステルに、第3成分として前記2成分の中間の極性を持つ特定の脂環式エステルを加えて3元共重合すると、生成するポリマーの分子間及び分子内における組成分布の拡大を回避できると共に、合成コストも低減できることを見出した。本発明はこれらの知見に基づいて完成されたものである。

1 【0009】すなわち、本発明は、(A) ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、(B) 炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステル、及び(C) 極性の置換基を有する炭化水素基又は酸素原子含有複素環基がエステル結合を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物を提供する。

【0010】本発明のフォトレジスト用高分子化合物には、前記(A)、(B)及び(C)の3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合し、生成したポリマーを含む溶液を有機溶媒中に添加することにより沈殿又は再沈殿して得られるフォトレジスト用高分子化合物が含まれる。

【0011】上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒として、例えば、炭化水素、ハロゲン化炭化水

40 素、ニトロ化合物、ニトリル、エーテル、ケトン、エステル、カーボネート、アルコール、カルボン酸又はこれらの溶媒を含む混合溶媒などを使用できる。また、上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒は、少なくとも炭化水素を含むのが好ましい。また、上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒のFedorsの方法による溶解度パラメーターの値は、例えば、7.0(cal/cm³)¹/²~14.0(cal/cm³)¹/²~14.0(cal/cm³)¹/²~14.0の食田であるのが好ましい。

50 【0012】前記(メタ)アクリル酸エステル (C) の

Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値は、 例えば10.0 (cal/cm³) 1/2~11.5 (ca $1/cm^3$) 1/2 [20. 5MPa1/2~23. 5MPa 1/2] の範囲である。また、上記のフォトレジスト用高 分子化合物は、(メタ)アクリル酸エステル(C)の共 重合比率が1~50モル%であり、重量平均分子量が 1,000~500,000であってもよい。

【0013】また、上記フォトレジスト用高分子化合物 は、下記式(1)又は(2) 【化2】

(式中、R1、R1、R6は、それぞれ独立に、水素原子 又はメチル基を示す。R²は水素原子又は炭素数1~1 3の炭化水素基を示す。R'及びR'は、それぞれ独立 に、炭素数1~3の炭化水素基を示す。Rは炭素数2~ 20の炭化水素基を示す。R'及びR'は、前記Rの置換 30 基であり、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル 基、オキソ基又はカルボキシル基を示す。但し、R'及 びR®のうち少なくとも一方は水素原子以外の置換基で ある。R°はメチル基又はエチル基を示す。x、y、z t, 0. $9 \le x + y + z \le 1$, 0 < x < 0. 99, 0 < x < 0y<0.99、0.01≤z≤0.50を満たす数であ る)で表される共重合構造を有していてもよい。

【0014】さらに、上記フォトレジスト用高分子化合 物は、Fedorsの方法による溶解度パラメーターの 値が9.5 (cal/cm³) 1/2~12.0 (cal/ 40 $cm^{3})^{1/2}$ [19. 4MP $a^{1/2}\sim$ 24. 5MP $a^{1/2}$] の範囲であってもよい。

【0015】本発明は、また、(A) ラクトン環を含有 する炭素数6~20の脂環式炭化水素基がエステル結合 を構成する酸素原子に結合している (メタ) アクリル酸 エステル、(B)炭素数6~20の脂環式炭化水素基を 含有し且つ酸の作用により脱離可能な基がエステル結合 を構成する酸素原子に結合している (メタ) アクリル酸 エステル、及び(C)極性の置換基を有する炭化水素基

素原子に結合している (メタ) アクリル酸エステルの3 種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量 体混合物を共重合することを特徴とするフォトレジスト 用高分子化合物の製造法を提供する。

【0016】本発明は、さらに、上記のフォトレジスト 用高分子化合物と光酸発生剤を少なくとも含むフォトレ ジスト用樹脂組成物を提供する。

【0017】なお、本明細書では、「アクリル」と「メ タクリル」とを「(メタ)アクリル」、「アクリロイ 10 ル」と「メタクリロイル」とを「(メタ)アクリロイ ル」等と総称する場合がある。

[0018]

(4)

【発明の実施の形態】本発明のフォトレジスト用高分子 化合物は、(A)ラクトン環を含有する炭素数6~20 の脂環式炭化水素基がエステル結合を構成する酸素原子 に結合している (メタ) アクリル酸エステル、(B) 炭 素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用 により脱離可能な基がエステル結合を構成する酸素原子 に結合している (メタ) アクリル酸エステル、及び

20 (C)極性の置換基を有する炭化水素基がエステル結合 を構成する酸素原子に結合している(メタ)アクリル酸 エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なく とも含む単量体混合物の共重合体で構成されている。

【0019】前記(メタ)アクリル酸エステル(A)に おける「ラクトン環を含有する炭素数6~20の脂環式 炭化水素基」には、ラクトン環と脂環式炭素環とが縮合 した構造を有する基が含まれる。前記脂環式炭素環は単 環であっても多環(橋かけ環)であってもよい。

【0020】前記(メタ)アクリル酸エステル(A)と して、例えば、下記式(3)又は(4) 【化3】

(式中、R¹¹、R¹²、R¹³及びR¹⁴は、それぞれ独立 に、水素原子又はメチル基を示し、X1、X1及びX *は、それぞれ独立に、-CH2-又は-CO-O-を示 す。但し、X1、X1及びX1のうち少なくとも1つは-CO-O-である。R¹¹は、水素原子又はメチル基を示 し、R¹⁶、R¹⁷、R¹⁸及びR¹⁹は、それぞれ独立に、水 素原子又は炭素数1~13の炭化水素基を示す)で表さ れる化合物が挙げられる。これらのモノマーにおいて異 性体が存在する場合には、それらは単独で又は混合物と して使用できる。なお、前記式(3)において、X1、 又は酸素原子含有複素環基がエステル結合を構成する酸 50 X'、X'における-CO-O-の左右の向きは問わな

30

【0021】前記R¹⁶、R¹⁷、R¹⁸、R¹⁹における炭素 数1~13の炭化水素基としては、例えば、メチル、エ チル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、 s - ブチル、t - ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチ ル、2-エチルヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル 基などのC、、、、脂肪族炭化水素基;シクロプロビル、シ クロペンチル、シクロヘキシル、シクロオクチル基など のC,-,,脂環式炭化水素基;フェニル、ナフチル基など のC6-1, 芳香族炭化水素基などが例示される。 これらの 10 中でも、炭素数1~8の炭化水素基(例えば、C_{1-s}脂 肪族炭化水素基など)が好ましく、特にC...アルキル 基が好ましい。R16、R17、R18、R19としては、水素 原子又はメチル基である場合が多い。

【0022】前記式(3)又は(4)で表される代表的 な化合物として下記の化合物が挙げられる。

[A-1] 1 - (メタ) アクリロイルオキシー4-オキサ トリシクロ[4.3.1.13.8] ウンデカン-5-オ ン $(R^{11} = H X は C H_3, R^{12} = R^{13} = R^{14} = H, X^2 =$ -CO-O-(左側がR¹¹の結合している炭素原子 側)、X1=X3=-CH2-)

[A-2] 1-(メタ) アクリロイルオキシー4, 7-ジ オキサトリシクロ[4.4.1.13.8]ドデカンー 5, 8-ジオン $(R^{11}=H又はCH, R^{12}=R^{13}=R$ 11=H、X1=-CO-O-(左側がR11の結合してい る炭素原子側)、X'=-CO-O-(左側がR''の結 合している炭素原子側)、X'=-CH,-)

[A-3] 5 - (メタ) アクリロイルオキシ-7-オキサ トリシクロ[4.2.1.0^{2.6}] ノナン-8-オン(R $^{15} = H又はCH$, $R^{16} = R^{17} = R^{18} = R^{19} = H$) 【0023】上記式(3)で表される化合物のうち、X '=-CO-O-、X'=X'=-CH,-である化合物 (3-1)は、例えば、下記反応工程式に従って得ること ができる。

[164]

(式中、R*は、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アル コキシ基又はアルケニルオキシ基を示す。R¹¹、R¹²、 R¹³、R¹⁴は前記に同じ)

【0024】 この反応工程式において、式(10)で表さ

れる化合物は、式(9)で表される2-アダマンタノン 化合物を、N-ヒドロキシフタルイミド等のN-ヒドロ キシイミド系触媒と、バナジウム化合物 (例えば、バナ ジウム (III) アセチルアセトナト等) 及びマンガン化 合物(例えば、マンガン(II)アセチルアセトナト等) の存在下、酸素と反応させることにより得ることができ る。この際、N-ヒドロキシイミド系触媒の使用量は、 式(9)で表される化合物1モルに対して、例えば0. 000001~1モル、好ましくは0.00001~ 0.5モル程度である。また、バナジウム化合物及びマ ンガン化合物の総使用量は、例えば、式(9)で表され る化合物1モルに対して、0.001~0.7モル、 好ましくは0.001~0.5モル程度である。バナジ ウム化合物とマンガン化合物との比率 (金属原子比) は、例えば、前者/後者=99/1~1/99、好まし くは95/5~10/90程度である。酸素は式(9) で表される化合物に対して過剰量用いる場合が多い。反 応は、例えば、酢酸などの有機酸、アセトニトリルなど のニトリル類、ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水 素などの溶媒中、常圧又は加圧下、20~200℃程 度、好ましくは30~150℃程度の温度で行われる。 【0025】 とうして得られた式 (10) で表される5-ヒドロキシ-2-アダマンタノン化合物を、N-ヒドロ キシフタルイミド等のN-ヒドロキシイミド系触媒と、 必要に応じてコバルト化合物(例えば、酢酸コバルト、 コバルトアセチルアセトナト等) などの金属系助触媒の 存在下、第1級又は第2級アルコールと共に、分子状酸 素により酸化すると、バイヤービリガー型の反応が進行 して、式(11)で表される1-ヒドロキシ-4-オキサ トリシクロ[4.3.1.13.8] ウンデカン化合物が 生成する。前記第1級又は第2級アルコールとしては、 例えば、メタノール、エタノール、1-プロバノール、 2-プロパノール、s-ブチルアルコール、シクロヘキ サノール、1-フェニルエタノール、ベンズヒドロール などが挙げられる。好ましくは第2級アルコールであ る。前記アルコールは共酸化剤として機能し、通常、系 内でアルデヒド、カルボン酸又はケトンに変換される。 N-ヒドロキシイミド系触媒は、式 (10) の化合物1モ ルに対して、例えば0.00001~1モル、好まし くは0.0001~0.5モル程度である。また、金 属系助触媒の使用量は、式(10)の化合物 1 モルに対し て、例えば0.0001~0.7モル、好ましくは0. 001~0.5モル程度である。前記アルコールの使用 量は、式(10)の化合物1モルに対して、例えば0.5 \sim 100モル、好ましくは $1\sim$ 50モル程度である。酸 素は式(10)の化合物に対して過剰量用いる場合が多 い。反応は、例えば、酢酸などの有機酸、アセトニトリ ル、ベンゾニトリルなどのニトリル類、トリフルオロメ チルベンゼンなどのハロゲン化炭化水素、酢酸エチルな 50 どのエステル類等の溶媒中、常圧又は加圧下、20~2

00℃程度、好ましくは30~150℃程度の温度で行われる。なお、式(11)の化合物は、一般的なバイヤービリガー反応、すなわち、化合物(10)と過酸化水素等の過酸化物やm-クロロ過安息香酸等の過酸との反応により得ることもできる。

【0026】上記反応で生成した1-ヒドロキシ-4-オキサトリシクロ[4.3.1.13.8] ウンデカン化 合物(11)と(メタ)アクリル酸又はその誘導体(12) との反応 (エステル化反応) は、酸触媒やエステル交換 触媒を用いた慣用の方法により行うことができる。ま た、化合物(11)と(メタ)アクリル酸ビニル、(メ タ)アクリル酸2-プロペニルなどの(メタ)アクリル 酸アルケニルとを、周期表第3族元素化合物触媒(例え ば、酢酸サマリウム、トリフルオロメタンスルホン酸サ マリウム、サマリウム錯体などのサマリウム化合物等) の存在下で反応 (エステル交換反応) させると、温和な 条件下で効率よく式(3a)で表される化合物を得ること ができる。この場合、(メタ)アクリル酸アルケニルの 使用量は、化合物(11)1 モルに対して、例えば0.8 表第3族元素化合物触媒の使用量は、化合物(11)1モ ルに対して、例えば0.001~1モル、好ましくは 0.01~0.25モル程度である。この反応は、反応 に不活性な溶媒中、例えば0~150℃、好ましくは2 5~120℃程度の温度で行われる。

【0027】上記式(3)で表される化合物のうち、X¹=-CO-O-で且つX²=X³=-CH₂-である化合物、X³=-CO-O-で且つX¹=X²=-CH₂-である化合物は、対応するアダマンタノン化合物から上記と同様の方法により製造できる。また、-CO-O-基を複数個有する化合物は、対応するアダマンタンジオン化合物等から上記の方法に準じて製造できる。また、前記式(4)で表される化合物は、公知乃至慣用の方法又はそれらの方法に準じた方法により製造できる。

【0028】前記(メタ)アクリル酸エステル(B)における「炭素数6~20の脂環式炭化水素基を含有し且つ酸の作用により脱離可能な基」には、エステル結合を構成する酸素原子との結合部位に第3級炭素原子を有する基が含まれる。前記脂環式炭化水素基は、エステル結合を構成する酸素原子と直接結合していてもよく、アルキレン基等を介して結合していてもよい。前記炭素数6~20の脂環式炭化水素基は単環式炭化水素基であってもよく、多環式(橋かけ環式)炭化水素基であってもよい。

【0029】前記 (メタ) アクリル酸エステル (B) として、例えば、下記式 (5) 又は (6) 【化5】

(式中、R²¹、R²¹、R²¹及びR²¹は、それぞれ独立 に、水素原子又はメチル基を示し、R²¹はメチル基又は エチル基を示す。R²⁶、R²⁹、R²⁹及びR²¹は、それぞ れ独立に、水素原子又はメチル基を示し、R²¹及びR²⁸は、それぞれ独立に、炭素数1~8の炭化水素基を示 す)で表される化合物が挙げられる。これらのモノマー において異性体が存在する場合には、それらは単独で又 は混合物として使用できる。

ができる。との場合、(メタ)アクリル酸アルケニルの 使用量は、化合物(11)1 モルに対して、例えば0. 8 本基としては、例えば、メチル、エチル、プロビル、インラモル、好ましくは $1\sim 1$. 5 モル程度である。周期 20 カルに対して、例えば0. 0 0 $1\sim 1$ モル、好ましくは かん、オクチル基などの0 $1\sim 1$ モルに対して、例えば $0\sim 1$ $1\sim 1$ モルに対して、例えば $1\sim 1$ $1\sim 1$ カルに対して、例えば $1\sim 1$ $1\sim 1$

【0031】前記式(5)又は(6)で表される化合物の代表的な例として下記の化合物が挙げられる。

(B-1) 2-(メタ) アクリロイルオキシ-2-メチル アダマンタン(R²¹=H又はCH₃、R²²=CH₃、R²³ =R²⁴=R²⁵=H)

[8-3] $1 - (1 - (メタ) アクリロイルオキシー 1 - メチルエチル) アダマンタン (<math>R^{16} = H Z \& CH_3$ 、 $R^{29} = R^{39} = R^{31} = H$)

[8-4] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-40 エチルプロビル) アダマンタン (R²⁶=H又はCH₃、 R²⁷=R²⁸=CH₂CH₃、R²⁹=R³⁰=R³¹=H) [8-5] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-メチルプロビル) アダマンタン (R²⁶=H又はCH₃、 R²⁷=CH₃、R²⁸=CH₂CH₃、R²⁹=R³⁰=R³¹=

50 【0032】上記式(5)で表される化合物は、例え

ば、下記反応工程式に従って得ることができる。

(式中、Xはハロゲン原子を示す。R^{**}、R^{**}、R^{**}、R^{**}、R^{**}、

【0033】 この反応工程式において、Xにおけるハロゲン原子としては、塩素、臭素、ヨウ素原子などが挙げられる。アダマンタノン誘導体(13)とグリニヤール試薬(14)との反応は、慣用のグリニヤール反応に準じて行うことができる。グリニヤール試薬(14)の使用量は、アダマンタノン誘導体(13)1 モルに対して、例えば0.7~3 モル、好ましくは0.9~1.5 モル程度である。反応は、反応に不活性な溶媒、例えば、ジェチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類等の中で行われる。反応温度は、例えば0~150℃、好ま※20

※しくは20~100℃程度である。

10 【0034】 こうして得られる2-アダマンタノール誘導体(15)を(メタ)アクリル酸又はその誘導体(16)と反応させることにより(エステル化反応)、前記式(5)で表される化合物を得ることができる。エステル化反応は、前記式(11)の化合物と(メタ)アクリル酸又はその誘導体(12)との反応に準じて行うことができる。

【0035】前記式(6)で表される化合物は、例えば、下記反応工程式に従って得ることができる。 【化7】

(式中、X、R²⁶、R²⁷、R²⁸、R²⁹、R³⁹、R³¹、R
*は前記に同じ)

【0036】 この反応工程式において、アダマンタン誘導体(17)と1,2-ジカルボニル化合物(例えば、ピアセチルなど)(18)及び酸素との反応は、コバルト化合物(例えば、酢酸コバルト、コバルトアセチルアセトナト等)などの金属化合物及び/又はN-ヒドロキシフタルイミドなどのN-ヒドロキシイミド系触媒の存在下で行うことができる。1,2-ジカルボニル化合物(18)の使用量は、アダマンタン誘導体(17)1 モルに対して1モル以上(例えば1~50モル)、好ましくは1.5~20モル、さらに好ましくは3~10モル程度である。前記金属化合物の使用量は、アダマンタン誘導体(17)1 モルに対して、例えば0.0001~0.1 モル程度である。N-ヒドロキシイミド系触媒の使用量は、アダマンタン誘導体(17)1 モルに対して、例えば0.00001~0.7 モル程度である。酸素は50

アダマンタン誘導体(17)に対して過剰量用いる場合が多い。反応は、通常、有機溶媒中で行われる。有機溶媒としては、例えば、酢酸などの有機酸、ベンゾニトリルなどのニトリル類、トリフルオロメチルベンゼンなどのハロゲン化炭化水素などが挙げられる。反応は、常圧又は加圧下、例えば30~250℃、好ましくは40~200℃程度の温度で行われる。

【0037】 こうして得られるアシルアダマンタン誘導体(19)とグリニヤール試薬(20)との反応は、通常のグリニヤール反応に準じて行うことができる。グリニヤール試薬(20)の使用量は、アシルアダマンタン誘導体(19) 1 モルに対して、例えば0.7~3 モル、好ましくは0.9~1.5 モル程度である。反応は、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類等の中で行われる。反応温度は、例えば0~150℃、好ましくは20~100℃程度である。

【0038】上記反応で生成したアダマンタンメタノー

*

14

ル誘導体(21)と(メタ)アクリル酸又はその誘導体 (22)との反応(エステル化反応)は、前記式(11)で 表される化合物と(メタ)アクリル酸又はその誘導体

13

(12) との反応に準じて行うことができる。

* 【0039】また、上記式(6)で表される化合物のうち、R'とR'とが同一の基である化合物は、例えば、下記反応工程式に従って得ることができる。 【化8】

[0040] 前記R*における炭化水素基としては、例えば、メチル、エチル、プロビル、イソプロビル基などのC1-6脂肪族炭化水素基;フェニル基等が挙げられる。

【0041】この反応工程式において、原料として用い るアダマンタンカルボン酸誘導体(23)は、アダマンタ ン化合物のアダマンタン環にカルボキシル基を導入する ことにより製造できる。例えば、アダマンタン化合物を N-ヒドロキシフタルイミドなどのN-ヒドロキシイミ ド系触媒と、必要に応じて、コバルト化合物(例えば、 酢酸コバルト、コバルトアセチルアセトナト等)などの 金属系助触媒の存在下、一酸化炭素及び酸素と接触させ ることにより、アダマンタン化合物のアダマンタン環に カルボキシル基を導入できる。このカルボキシル化反応 において、N-ヒドロキシイミド系触媒の使用量は、ア ダマンタン化合物1モルに対して、例えば0.0000 01~1モル、好ましくは0.00001~0.5モル 程度である。また、金属系助触媒の使用量は、アダマン タン化合物1モルに対して、例えば0.0001~0. 7モル、好ましくは0.001~0.5モル程度であ る。一酸化炭素及び酸素の使用量は、例えば、アダマン タン化合物 1 モルに対して、それぞれ 1 モル以上及び 0.5モル以上である。一酸化炭素と酸素の割合は、例 えば、前者/後者(モル比)=1/99~99/1程 度、好ましくは50/50~95/5程度である。カル ボキシル化反応は、例えば、酢酸などの有機酸、アセト ニトリルなどのニトリル類、ジクロロエタンなどのハロ ゲン化炭化水素などの溶媒中、常圧又は加圧下、0~2 00℃程度、好ましくは10~150℃程度の温度で行 われる。なお、反応条件を選択することにより、アダマ ンタン環に複数のカルボキシル基を導入できる。

【0042】アダマンタンカルボン酸誘導体(23)とヒドロキシ化合物(24)との反応は、例えば酸触媒等を用20 いた慣用のエステル化法に従って行うことができる。式(25)で表されるアダマンタンカルボン酸エステルとグリニヤール試薬(20)との反応は、通常、反応に不活性な溶媒、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類中などで行われる。反応温度は、例えば0~100℃程度、好ましくは10~40℃程度である。グリニヤール試薬(20)の使用量は、アダマンタンカルボン酸エステル(25)に対して、例えば2~4当量程度である。

[0043] アダマンタンメタノール誘導体(21a)と(メタ)アクリル酸又はその誘導体(22)との反応(エステル化反応)は、前記式(11)で表される化合物と(メタ)アクリル酸又はその誘導体(12)との反応に準じて行うことができる。このようにして、式(6)で表される化合物のうち、 R^2 と R^3 とが同一の炭化水素基である(例えば、 $R^2=R^3=x$ チル基)化合物(6a)を簡易に調製することができる。

【0044】前記(メタ)アクリル酸エステル(C)における「極性の置換基を有する炭化水素基」としては、ヒドロキシル基、オキソ基、カルボキシル基、アミノ基、スルホン酸基、置換オキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ基等のアルコキシ基等の炭化水素基置換オキシ基など)などの極性基を1又は2以上(好ましくは1~3個程度)有する炭化水素基が挙げられる。好ましい極性基には、ヒドロキシル基、オキソ基及びカルボキシル基が含まれる。なお、(メタ)アクリル酸エステル(C)には、前記(メタ)アクリル酸エステル(A)は含まれない。

【0045】前記炭化水素基には、メチル、エチル、プロビル、イソプロビル、ブチル、イソブチル、s-ブチ50 ル、t-ブチル、ヘキシル、オクチル、デシル基などの

脂肪族炭化水素基(例えば、C1-20脂肪族炭化水素 基);シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチ ル、シクロヘキシル、シクロオクチル、シクロドデシ ル、アダマンチル、ノルボルニル、パーヒドロナフチル 基などの脂環式炭化水素基(例えば、3~20員の単環 又は多環(橋かけ環)の脂環式炭化水素基);フェニ ル、ナフチル基などの芳香族炭化水素基 (例えば、C 6-20 芳香族炭化水素基); これらが、酸素原子、エステ ル結合、アミド結合等の連結基を介して又は介すること なく、複数個結合した炭化水素基(例えば、2つの脂肪 族炭化水素基が連結基を介して結合した基、脂環式炭化 水素基と脂肪族炭化水素基が結合した基、芳香族炭化水 素基と脂肪族炭化水素基が結合した基) などが含まれ る。上記の炭化水素基は、前記極性基のほか、必要に応 じて他の置換基を有していてもよい。

【0046】前記 (メタ) アクリル酸エステル (C) に おける「酸素原子含有複素環基」としては、テトラヒド ロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、オキセパニル 基などの非芳香族性又は芳香族性の酸素原子含有複素環 基が挙げられる。これらの酸素原子含有複素環基の複素 環には、置換基が結合していてもよく、また芳香族性又 は非芳香族性の炭素環又は複素環が縮合していてもよ 61

【0047】前記 (メタ) アクリル酸エステル (C) と して、例えば、下記式(7) [化9]

(式中、R"は水素原子又はメチル基を示し、Rは炭素 数2~20の炭化水素基を示し、R'''及びR'''は、それ ぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基又は カルボキシル基を示す。但し、R33及びR34のうち少な くとも一方は水素原子以外の置換基である)で表される 化合物が挙げられる。これらのモノマーにおいて異性体 が存在する場合には、それらは単独で又は混合物として 使用できる。

【0048】前記式中、Rにおける炭素数2~20の炭 化水素基としては、前記例示の炭化水素基のうち炭素数 が2~20のもの(例えば、Cュ-ュ。脂肪族炭化水素基、 3~20員の単環又は多環(橋かけ環)の脂環式炭化水 素基、C。- 2。芳香族炭化水素基など)が挙げられる。 C れらの炭化水素基は、前記極性基のほか、必要に応じて 他の置換基を有していてもよい。これらの中でも、エチ ル基、プロピル基などのC2-4アルキル基、6~20員 の脂環式炭化水素基が好ましい。

【0049】前記式(7)で表される化合物の一例とし 50

て、下記式(8) 【化10】

$$CH_2 = C_C^{R^{32}}$$
 $C = 0$
 R^{33}
 R^{34}
 R^{34}

(式中、R''、R''及びR''は前記に同じ。R'''及びR 10 3・はアダマンタン環に結合している置換基である)で表 される化合物が挙げられる。

【0050】前記式(7)又は(8)で表される化合物 の代表的な例として下記の化合物が例示される。なお、 化合物名の後ろの数値は後述の溶解度パラメーターの値 (2つの数字はアクリレート/メタクリレートを示す) である。

[C-1] 1-(メタ) アクリロイルオキシ-3-ヒドロ キシアダマンタン(式(8); R32 = H又はCH, R 33 = OH, R^{34} = H) [11. 14 (cal/cm³) 1/2/10.86 (cal/cm³) 1/2 (= 22.78 MPa^{1/2}/22. 21MPa^{1/2})]

[C-2] 1 - (メタ) アクリロイルオキシアダマンタン -4-オン(式(8):R³²=H又はCH, R³³=4 -オキソ基、R''=H) [10.95 (cal/c m^3) 1/2/10.66 (cal/cm³) 1/2 (= 22. $39MPa^{1/2}/21.80MPa^{1/2})$

[C-3] 1 - (メタ) アクリロイルオキシ-3-カルボ キシアダマンタン(式(8); R32=H又はCH₃、R 33 = COOH, R^{34} = H) [10.71 (cal/cm 30 3) $\frac{1}{2}$ /10. 58 (cal/cm³) $\frac{1}{2}$ (=21. 9) 0MPa^{1/2}/21.64MPa^{1/2})]

[C-4] 1 - (メタ) アクリロイルオキシ-3.5-ジ カルボキシアダマンタン(式(8); R32 = H又はCH $_{3}, R^{33} = R^{34} = COOH)$ [11. 41 (cal/c m^3) 1/2/11. 25 (cal/cm³) 1/2 (= 23. $33MPa^{1/2}/23.01MPa^{1/2})$

【0051】本発明において、好ましい(メタ)アクリ ル酸エステル (C) は、Fedorsの方法 [Polym. E ng. Sci., 14, 147(1974)参照]による溶解度パラメー ターの値(以下、単に「SP値」と称することがある) $30.0 (cal/cm')^{1/2} \sim 11.5 (cal/cm')$ cm^3) 1/2 [20. 5MPa1/2~23. 5MPa1/2] の範囲である。このような(メタ)アクリル酸エステル (C)を用いると、特に各モノマー単位が均一に分布し たランダム共重合体を得ることができる。

【0052】前記式(8)で表される化合物は、例え ば、下記反応工程式に従って得ることができる。 【化11】

(式中、R''、R''、R''、R'なは前記に同じ)
[0053] この反応工程式において、1-アダマンタノール誘導体(26)と(メタ)アクリル酸又はその誘導体(27)との反応は、前記化合物(11)と(メタ)アクリル酸又はその誘導体(12)との反応に準じて行うことができる。原料として用いる1-アダマンタノール誘導体(26)は、例えば、アダマンタン化合物のアダマンタン環にヒドロキシル基又はカルボキシル基を導入することにより得られる。アダマンタン環へのカルボキシル基の導入は前記と同様にして行うことができる。アダマンタン環へのヒドロキシル基の導入は次のようにして行うことができる。

【0054】例えば、アダマンタン化合物をN-ヒドロ キシフタルイミド等のN-ヒドロキシイミド系触媒と、 必要に応じてコバルト化合物(例えば、酢酸コバルト、 コバルトアセチルアセトナト等)などの金属系助触媒の 存在下、酸素と接触させることにより、アダマンタン環 にヒドロキシル基を導入できる。この方法において、N - ヒドロキシイミド系触媒の使用量は、アダマンタン化 合物1モルに対して、例えば0.000001~1モ ル、好ましくは0.0001~0.5モル程度であ る。また、金属系助触媒の使用量は、アダマンタン化合 30 物1モルに対して、例えば0.0001~0.7モル、 好ましくは0.001~0.5モル程度である。酸素は アダマンタン化合物に対して過剰量用いる場合が多い。 反応は、例えば、酢酸などの有機酸、アセトニトリルな どのニトリル類、ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化 水素などの溶媒中、常圧又は加圧下、0~200℃程 度、好ましくは30~150℃程度の温度で行われる。 反応条件を選択することにより、アダマンタン環に複数 のヒドロキシル基を導入することができる。

【0055】本発明のフォトレジスト用高分子化合物に 40 おいて、前記3種の(メタ)アクリル酸エステル

(A)、(B)及び(C)の共重合比率は、それらの組み合わせに応じて適宜設定できるが、(メタ)アクリル酸エステル(A)の比率は、通常1~99モル%、好ましくは10~95モル%、さらに好ましくは30~85モル%程度であり、(メタ)アクリル酸エステル(B)の比率は、通常1~99モル%、好ましくは5~80モル%、さらに好ましくは15~70モル%程度であり、(メタ)アクリル酸エステル(C)の比率は、通常1~50モル%、好ましくは2~40モル%、さらに好まし

くは3~30モル%程度である。

【0056】本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、フォトレジスト用樹脂としての特性を損なわない範囲で、前記3種の(メタ)アクリル酸エステル以外のモノマーが共重合されていてもよい。前記3種の(メタ)アクリル酸エステル以外のモノマーの共重合比率は、例えば0~10モル%、好ましくは0~5モル%程度である。

18

【0057】本発明の好ましいフォトレジスト用高分子化合物は、前記式(1)又は(2)で表される共重合構造を有する。前記式(1)、(2)中、ノルボルナン環上の置換基である R^* における炭素数 $1\sim13$ の炭化水素基としては、前記 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} 及び R^{18} における炭素数 $1\sim13$ の炭化水素基と同様の基が挙げられる。 R^* 、 R^* における炭素数 $1\sim3$ の炭化水素基としては、例えば、メチル、エチル、プロビル、イソプロビル基などが挙げられる。Rにおける炭素数 $2\sim2$ 0の炭化水素基としては、前記例示の炭化水素基が挙げられる。

[0058]式中、x、y及びzは、それぞれのモノマ 20 一単位 (繰り返し単位)のポリマーにおけるモル分率を示す。xは、0 < x < 0 . 99の範囲にあり、好ましくは0. 10 \sim 0 . 95程度、さらに好ましくは0. 30 \sim 0 . 85程度である。yは、0 < y < 0 . 99の範囲にあり、好ましくは0. 05 \sim 0 . 80程度、さらに好ましくは0. 15 \sim 0 . 70程度である。z は、0 . 0 $1 \le z \le 0$. 50の範囲にあり、好ましくは0. 02 \sim 0 . 40程度、さらに好ましくは0. 03 \sim 0 . 30程度である。

【0059】本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、Fedorsの方法[Polym. Eng. Sci., 14, 147 (1974)参照]による溶解度パラメーターの値(以下、単に「SP値」と称することがある)が9.5 (cal/cm³) 1/2~12 (cal/cm³) 1/2 [=19.4 (J/cm³) 1/2~24.6 (J/cm³) 1/2] [=19.4 4MPa¹/2~24.5MPa¹/2]の範囲にあるのが好ましい。

【0060】このような溶解度パラメーターを有する高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を半導体基板(シリコンウェハー)に塗布して形成されたレジスト塗膜は、基板に対する接着性(密着性)に優れるとともに、アルカリ現像により解像度の高いパターンを形成するとができる。溶解度パラメーターの値が9.5(cal/cm³)¹/²[=19.4 (J/cm³)¹/²][=19.4MPa¹/²]より低いと、基板に対する接着性が低下して、現像によりパターンが剥がれて残らないという問題が起こりやすい。また、溶解度パラメーターの値が12(cal/cm³)¹/²[=24.6 (J/cm³)¹/²][=24.5MPa¹/²]より大きいと、基板にはじかれて塗布することが困難になりやすい上、アルカリ現像液に対する親和性が高くなり、その結果、

露光部と未露光部の溶解性のコントラストが悪くなって 解像度が低下しやすくなる。

【0061】前記高分子化合物のSP値の上限は、より好ましくは11.5 (cal/cm³) ¹/² [=23.5 MPa¹/²]、特に好ましくは11.3 (cal/cm³) ¹/² [=23.1 MPa¹/²]である。また、前記高分子化合物のSP値の下限は、より好ましくは10.0 (cal/cm³) ¹/² [=20.5 MPa¹/²]、さらに好ましくは10.5 (cal/cm³) ¹/² [=21.5 MPa¹/²]、特に好ましくは10.8 (cal/cm³) ¹/² [=22.1 MPa¹/²] である。

【0062】前記高分子化合物のSP値は、公知の方法、例えば、「ポリマーハンドブック(Polymer Handbook)」、第4版、VII-675頁~VII-711頁(特に、VII-680頁~VII-683頁)に記載の方法により求めることができる。より具体的には、前記SP値を求める方法として、溶解力試験法、浸透圧法、膨潤度法、濁り度法、比容法、固有粘度法、逆相ガスクロマトグラフィー法、屈折率法、双極子モーメント法、水素結合パラメーター法、グループ寄与法、ハンセンパラメーター法などが挙げられ、これらの方法により得られたSP値を本発明における前記高分子化合物のSP値として使用できる。なお、上記溶解力試験法において使用する溶媒は、前記文献の表1(VII-683頁)に列記されている。

【0063】本発明では、高分子化合物の重量平均分子量(Mw)は、例えば1,000~500,000程度、好ましくは3,000~50,000程度であり、分子量分布(Mw/Mn)は、例えば1.5~3.5程度である。なお、前記Mnは数平均分子量(ポリスチレン換算)を示す。

【0064】本発明のフォトレジスト用高分子化合物 は、前記(メタ)アクリル酸エステル(A)、(メタ) アクリル酸エステル(B)、及び(メタ)アクリル酸エ ステル(C)の3種の(メタ)アクリル酸エステルを少 なくとも含むモノマー混合物を共重合させることにより 得ることができる。(メタ)アクリル酸エステル (A)、(メタ)アクリル酸エステル(B)、及び(メ タ) アクリル酸エステル (C) は、それぞれ単独で又は 2以上を組み合わせて使用できる。重合は、溶液重合、 溶融重合など、アクリル系ポリマーを製造する際に用い 40 る慣用の方法により行うことができる。重合溶媒として は公知の溶媒を使用でき、例えば、エーテル(ジエチル エーテル等の鎖状エーテル、テトラヒドロフラン、ジオ キサン等の環状エーテルなど)、エステル(酢酸メチ ル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチルなど)、ケト ン(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチル ケトンなど)、アミド(N, N-ジメチルアセトアミ ド、N, N-ジメチルホルムアミドなど)、スルホキシ ド (ジメチルスルホキシドなど)、アルコール (メタノ

ンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、ヘキサン等の脂肪族炭化水素、シクロヘキサン等の脂環式炭化水素など)、これらの混合溶媒などが挙げられる。また、重合開始剤として公知の重合開始剤を使用できる。重合温度は、例えば30~150℃程度の範囲で適宜選択できる。

【0065】本発明のフォトレジスト用髙分子化合物 は、好ましくは、前記 (メタ) アクリル酸エステル (A)、(メタ)アクリル酸エステル(B)、及び(メ 10 タ) アクリル酸エステル (C) の3種の (メタ) アクリ ル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合 し、生成したボリマーを含む溶液 (例えば、前記重合溶 媒の溶液)を有機溶媒中に添加することにより沈殿又は 再沈殿して得られるフォトレジスト用高分子化合物であ る。このようなフォトレジスト用高分子化合物では、モ ノマーや、オリゴマー等の低分子量物が沈殿及び/又は 再沈殿操作の際に有機溶媒に溶解して容易に除去される ため、フォトレジスト用樹脂として用いた場合に、微細 なパターンを精度よく形成することができる。なお、沈 殿又は再沈殿操作の際に水を沈殿又は再沈殿溶媒として 用いた場合には、前記低分子量物は水に溶解しにくいた め十分に除去することができない。そのため、得られた 髙分子化合物をフォトレジスト用樹脂として用いた際、 微細なパターンを精度よく形成することができないこと がある。

【0066】前記沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機 溶媒として、例えば、炭化水素(ペンタン、ヘキサン、 ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素;シクロヘキ サン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素;ベ ンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素)、 ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、クロロホルム、四 塩化炭素などのハロゲン化脂肪族炭化水素;クロロベン ゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水 素など)、ニトロ化合物(ニトロメタン、ニトロエタン など)、ニトリル(アセトニトリル、ベンゾニトリルな ど)、エーテル (ジエチルエーテル、ジイソプロピルエ ーテル、ジメトキシエタンなどの鎖状エーテル;テトラ ヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル)、ケト ン(アセトン、メチルエチルケトン、ジイソブチルケト ンなど)、エステル(酢酸エチル、酢酸ブチルなど)、 カーボネート (ジメチルカーボネート、ジエチルカーボ ネート、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネー トなど)、アルコール (メタノール、エタノール、プロ パノール、イソプロピルアルコール、ブタノールな ど)、カルボン酸(酢酸など)、これらの溶媒を含む混 合溶媒等が挙げられる。

「クトンなど」、アミド(N, Nージメチルアセトアミ 【0067】中でも、前記沈殿又は再沈殿溶媒として用 ド、N, Nージメチルホルムアミドなど)、スルホキシ ド(ジメチルスルホキシドなど)、アルコール(メタノ サンなどの脂肪族炭化水素)を含む溶媒が好ましい。こ ール、エタノール、プロパノールなど)、炭化水素(ベ 50 のような少なくとも炭化水素を含む溶媒において、炭化 水素(例えば、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素)と他の溶媒との比率は、例えば前者/後者(体積比:25°C)= $10/90\sim99/1$ 、好ましくは前者/後者(体積比:25°C)= $30/70\sim98/2$ 、さらに好ましくは前者/後者(体積比:25°C)= $50/50\sim97/3$ 程度である。

【0068】前記沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒のFedorsの方法による溶解度パラメーター(以下、単に「SP値」と称することがある)の値は、7.0(cal/cm³)¹''~14.0(cal/cm 10³)¹''[14.3MPa¹''~28.6MPa¹']の範囲であるのが好ましい。このような有機溶媒を沈殿又は再沈殿溶媒として用いると、フォトレジスト用樹脂として特に好適な組成分布を有する高分子化合物を得ることができる。

【0069】前記有機溶媒のSP値は、例えば、「ポリマーハンドブック(Polymer Handbook)」、第4版、VII-675頁~VII-711頁に記載の方法により求めることができる。また、前記有機溶媒のSP値として、該文献の表1(VII-683頁)、表7~8(VII-688頁~VII-711頁)の値を採用できる。前記有機溶媒が複数の溶媒の混合溶媒である場合のSP値は、公知の方法により求めることができる。例えば、混合溶媒のSP値は、加成性が成立するとして、各溶媒のSP値と体積分率との積の総和として求めることができる。

[0070] 前記有機溶媒のSP値は、より好ましくは7.0(cal/cm³)¹/²~9.0(cal/cm³)¹/²~18.4MPa¹/²]、及び12.0(cal/cm³)¹/²~14.0(cal/cm³)¹/²~14.5MPa¹/²~28.6MPa¹/²]の範囲であり、特に好ましくは7.5(cal/cm³)¹/²~8.5(cal/cm³)¹/²[15.3MPa¹/²~17.4MPa¹/²]、及び13.0(cal/cm³)¹/²~14.0(cal/cm³)¹/²[26.6MPa¹/²~17.4MPa¹/²]、及び13.0(cal/cm³)¹/²~14.0(cal/cm³)¹/²[26.6MPa¹/²~28.6MPa¹/²]の範囲である。[0071]本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、前記本発明のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生剤とを含んでいる。

[0072] 光酸発生剤としては、露光により効率よく酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアゾニ 40 ウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードへキサフルオロホスフェートなど)、スルホニウム塩(例えば、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロホスフェート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホネートなど)、スルホン酸エステル [例えば、1-フェニルー1-(4-メチルフェニル)スルホニルオキシー1ーベンゾイルメタン、1、2、3-トリスルホニルオキシメチルベンゼン、1、3-ジニトロ-2-(4-フェニルスルホニルオキシメチル、ベンゼン、1-フェニル 50

-1-(4-メチルフェニルスルホニルオキシメチル)
-1-ヒドロキシ-1-ベンゾイルメタンなど]、オキサチアゾール誘導体、s-トリアジン誘導体、ジスルホン誘導体(ジフェニルジスルホンなど)、イミド化合物、オキシムスルホネート、ジアゾナフトキノン、ベンゾイントシレートなどを使用できる。これらの光酸発生剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

【0073】光酸発生剤の使用量は、光照射により生成する酸の強度や前記高分子化合物における各モノマー単位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、前記高分子化合物100重量部に対して0.1~30重量部、好ましくは1~25重量部、さらに好ましくは2~20重量部程度の範囲から選択できる。

【0074】フォトレジスト用樹脂組成物は、アルカリ 可溶性樹脂(例えば、ノボラック樹脂、フェノール樹脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など)などの アルカリ可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機溶媒(例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、アルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテル類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコールエーテルエステル類、これらの混合溶媒など)などを含んでいてもよい。

【0075】このフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介して、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さらに露光後ベークを行い)潜像パターンを形成し、次いで現像することにより、微細なパターンを高い精度で形成できる。

【0076】基材又は基板としては、シリコンウエハ、30 金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げられる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば0.1~20μm、好ましくは0.3~2μm程度である。

【0077】 露光には、種々の波長の光線、例えば、紫外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通常、g線、i線、エキシマレーザー (例えば、XeC1、KrF、KrCl、ArF、ArClなど) などが使用される。露光エネルギーは、例えば1~1000mJ/cm²、好ましくは10~500mJ/cm²程度である。

【0078】光照射により光酸発生剤から酸が生成し、 この酸により、例えば前記高分子化合物のアルカリ可溶 性ユニットのカルボキシル基等の保護基(脱離性基)が 速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等 が生成する。そのため、水又はアルカリ現像液による現 像により、所定のパターンを精度よく形成できる。 【0079】

) 【発明の効果】本発明によれば、特定の3種の(メタ)

アクリル酸エステルを共重合させるので、各モノマーユニットが偏在しないランダムな構造を有するとともに、合成コストを低減できる。また、基板に対する密着性、アルカリ可溶性及びエッチング耐性に優れるとともに、フォトレジスト用溶媒に溶解しやすい。そのため、フォトレジスト用樹脂として用いた場合、微細なパターンを高い精度で形成することができる。

[0080]

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定 10 されるものではない。なお、化合物番号(モノマー番号)の後ろに「アクリレート」とあるのは、明細書中に記載の化合物番号に相当する2つの化合物のうちアクリロイルオキシ基を有する化合物を示し、「メタクリレート」とあるのは、前記2つの化合物のうちメタクリロイルオキシ基を有する化合物を示す。構造式中の括弧の右下の数字は該モノマー単位のモル%を示す。

【0081】比較例1 下記構造の樹脂の合成

【化12】

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100m1丸底フ ラスコにモノマー [A-3] (メタクリレート) 2.24 g(10.00ミリモル)、モノマー[B-3](メタク リレート) 1. 76g(6. 72ミリモル)、及び開始 剤(和光純薬工業製V-65)0.40gを入れ、TH. F (テトラヒドロフラン) 16.00gに溶解させた。 続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温 度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反 応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1(体積比;25 °C) 混合液500mlに落とし、生じた沈殿物を濾別す ることで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再 度THF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作 を繰り返すことにより所望の樹脂 3. 32gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量 平均分子量)が7400、分子量分布(Mw/Mn)が 2. 04であった。1H-NMR (DMSO-ds中)分 析では、1.5-2.5ppm (ブロード) のほか、 3. 1 p p m、4. 6 p p m に強いシグナルが観測され た。ポリマーのSP値は10.99 (cal/cm³) ¹/² (=22. 47MPa¹/²) である。

【0082】比較例2 下記構造の樹脂の合成 【化13】

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フ ラスコにモノマー[A-3] (メタクリレート) 2.35 g (10.6ミリモル)、モノマー[B-1] (メタクリ レート) 1.65g(7.05ミリモル)、及び開始剤 (和光純薬工業製V-65)0.40gを入れ、THF (テトラヒドロフラン) 16.00gに溶解させた。続 いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度 を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応 液をヘキサンと酢酸エチルの9:1 (体積比;25℃) 混合液500mlに落とし、生じた沈殿物を濾別するこ とで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度T HF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰 20 り返すことにより所望の樹脂 3.13gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、Mw (重量平均 分子量)が7100、分子量分布(Mw/Mn)が1. 98であった。 H-NMR (DMSO-d。中) 分析で は、1.5-2.5ppm (プロード) のほか、3.1ppm、4.6ppmに強いシグナルが観測された。ポ リマーのSP値は11.06(cal/cm³) 1/2 (= 22.62MPa¹/²) である。

【0083】実施例1 下記構造の樹脂の合成

【化14】

$$+ CH_2 - \stackrel{CH_3}{\stackrel{C}{\stackrel{C}{\hookrightarrow}}} + CH_2 - \stackrel{CH_3}{\stackrel{C}{\stackrel{C}{\hookrightarrow}}} - CH_2 - \stackrel{CH_3}{\stackrel{C}{\stackrel{C}{\hookrightarrow}}} - CH_2 - \stackrel{CH_3}{\stackrel{C}{\hookrightarrow}} - CH_3$$

$$CH_3 - C - CH_3$$

$$CH_3 - C - CH_3$$

$$OH$$

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フラスコにモノマー [A-3] (メタクリレート) 2.06
40 g(9.28ミリモル)、モノマー [B-3] (メタクリレート) 1.54g(5.88ミリモル)、モノマー [C-1] [メタクリレート: SP値:10.86(cal/cm³)¹¹²(=22.21MPa¹¹²)] 0.40g(1.69ミリモル)、及び開始剤(和光純薬工業製V-65)0.40gを入れ、THF(テトラヒドロフラン)16.00gに溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1(体積比;25℃)混合液[SP値:507.65(cal/cm³)¹¹²(=15.64MPa¹²

2)] 500ml に落とし、生じた沈殿物を濾別するこ とで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度T HF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰 り返すことにより所望の樹脂 3.22gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均 分子量) が7600、分子量分布(Mw/Mn)が2. 00であった。¹H‐NMR(DMSO‐d₅中)分析で は、1.5-2.5ppm (ブロード) のほか、3.1 ppm、4.6ppm、4.7ppmに強いシグナルが $c m^3$) 1/2 (= 22. 52MP $a^{1/2}$) である。

25

[0084]実施例2 下記構造の樹脂の合成

【化15】

$$+ CH_{2} - \stackrel{CH_{3}}{\stackrel{\downarrow}{c}} + CH_{3} - \stackrel{CH_{3}}{\stackrel{\downarrow}{c}} + CH$$

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フ ラスコにモノマー [A-3] (メタクリレート) 2. 15 g (9.68ミリモル)、モノマー [B-1] (メタクリ レート) 1. 44g (6. 15ミリモル)、モノマー [C-1] [メタクリレート; SP値: 10. 86 (ca $1/c m^3$) 1/2 (= 22. 21MPa^{1/2})] 0. 41 g(1.75ミリモル)、及び開始剤(和光純薬工業製 V-65)0.40gを入れ、THF(テトラヒドロフ ラン)16.00gに溶解させた。続いて、フラスコ内 30 現像し、純水でリンスしたところ、何れの場合も、0. を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃に保ち、 窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応液をヘキサンと酢*

*酸エチルの9:1 (体積比;25℃) 混合液 [SP値: 7. 65 $(cal/cm^3)^{1/2}$ (=15. 64MPa^{1/2} ²)]500mlに落とし、生じた沈殿物を濾別すると とで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度T HF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰 り返すことにより所望の樹脂 3.05gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均 分子量)が7000、分子量分布 (Mw/Mn)が2. 05であった。¹H-NMR (DMSO-d₅中) 分析で 観測された。ポリマーのSP値は11.01(cal / 10 は、1.5-2.5 ppm(ブロード)のほか、3.1ppm、4.6ppm、4.7ppmに強いシグナルが 観測された。ポリマーのSP値は11.07 (cal/ $c m^3$) 1/2 (= 22. 64MP $a^{1/2}$) rado.

【0085】評価試験

上記比較例及び実施例で得られたボリマーのそれぞれに ついて、ポリマー100重量部とトリフェニルスルホニ ウムヘキサフルオロアンチモネート10重量部とを乳酸 エチルと混合して、ポリマー濃度17重量%のフォトレ ジスト用樹脂組成物を調製した。しかし、比較例で得ら 20 れたポリマーは乳酸エチルに溶解せず、露光評価に付す ことができなかった。実施例で得られたポリマーを使用 して調製したフォトレジスト用樹脂組成物をシリコンウ エハーにスピンコーティング法により塗布し、厚み1. 0μmの感光層を形成した。ホットプレート上で温度1 00℃で150秒間プリベークした後、波長247nm のKrFエキシマレーザーを用い、マスクを介して、照 射量30mJ/cm²で露光した後、100℃の温度で 60秒間ポストベークした。次いで、O. 3 Mのテトラ メチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により60秒間 20μmのライン・アンド・スペースパターンが得られ

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

HO1L 21/027 // C08L 33:04

Fターム(参考) 2H025 AA02 AA04 AA09 AA14 AB16 ACO4 ACO8 ADO3 BEO0 BE10 BG00 BJ10 CB14 CB41 2H096 AA25 BA11 EA05 EA23 LA30 4F070 AA32 CA20 CB11 4J100 AL08P AL08Q AL08R BA11 BC09 BC53 CA05 JA38

FΙ

テーマコード(参考)

CO8L 33:04 HO1L 21/30

502R